

淮北pcb线路板 安徽迅驰I获取

产品名称	淮北pcb线路板 安徽迅驰I获取
公司名称	合肥迅驰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区合欢路16号天怡商务中心2号创业楼二层
联系电话	13856069009 13856069009

产品详情

影响印刷电路板可焊性的因素主要有：焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高，则焊料扩散速度加快，此时具有很高的活性，会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化，产生焊接缺陷，电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷，这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。电路板焊接方法：1.准备施焊：烙铁头和焊锡靠近被焊工件并认准位置，处于随时可以焊接的状态，此时保持烙铁头干净可沾上焊锡。2.加热焊件：将烙铁头放在工件上进行加热，烙铁头接触热容量较大的焊件。3.熔化焊锡：将焊锡丝放在工件上，熔化适量的焊锡，在送焊锡过程中，可以先将焊锡接触烙铁头，然后移动焊锡至与烙铁头相对的位置，这样做有利于焊锡的熔化和热量的传导。此时注意焊锡一定要润湿被焊工件表面和整个焊盘。焊接电路板的注意事项：1、选择合适的焊接温度电烙铁的焊接温度过高或者过低，都容易造成焊接不良。2、焊接元器件遵循从小到大的原则焊接元器件要先焊接小，再焊接大。3、注意极性反向像一些电容、电阻、二极管和三极管，是有极性方向的，在焊接时要避免接反。

影响印刷电路板可焊性的因素主要有：翘曲产生的焊接缺陷电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲，由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB，由于板自身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm，如果电路板上器件较大，随着线路板降温后恢复正常形状，焊点将长时间处于应力作用之下，如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。对电路板焊接质量的检查方法有目视法、红外探测法、在线测试法等。在这几种方法中，经济、常用的是目视法，它经济方便、简单可行。其它几种方法需一定的设备支持。它们虽投资较大

，但可保证高的检查可靠性。电路板孔的可焊性影响焊接质量电路板孔可焊性不好，pcb线路板，将会产生虚焊缺陷，影响电路中元件的参数，导致多层板元器件和内层线导通不稳定，引起整个电路功能失效。所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质，即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。

电路板的结构，电路板：（1）信号层：主要用来放置元器件或布线。Protel DXP通常包含30个中间层，即Mid Layer1~Mid Layer30，中间层用来布置信号线，顶层和底层用来放置元器件或敷铜。（2）防护层：主要用来确保电路板上不需要镀锡的地方不被镀锡，从而保证电路板运行的可靠性。其中Top Paste和Bottom Paste分别为顶层阻焊层和底层阻焊层；Solder和Bottom Solder分别为锡膏防护层和底层锡膏防护层。

（3）丝印层：主要用来在电路板上印上元器件的流水号、生产编号、公司名称等。（4）内部层：主要用来作为信号布线层对电路板焊接质量的检查方法有目视法、红外探测法、在线测试法等。在这几种方法中，经济、常用的是目视法，它经济方便、简单可行。其它几种方法需一定的设备支持。它们虽投资较大，但可保证高的检查可靠性。焊接电路板的注意事项：进行集成电路芯片的焊接之前需保证芯片放置方向的正确无误。对于芯片丝印层，一般长方形焊盘表示开始的引脚。焊接时应先固定芯片一个引脚，对元器件的位置进行微调后固定芯片对角引脚，使元器件被准确连接位置上后进行焊接。

淮北pcb线路板-安徽迅驰|获取报价(图)由合肥迅驰电子科技有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥迅驰电子科技有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!